

铝砖系列制品

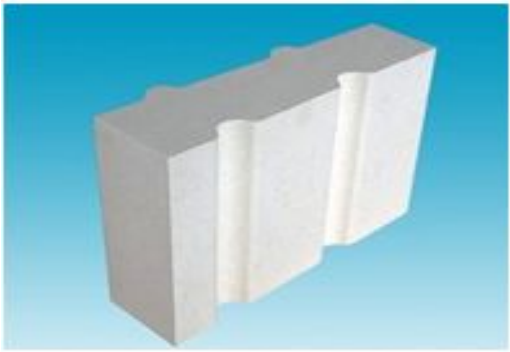
低蠕变莫来石砖

该产品以烧结莫来石、高温烧结粘土为原料，经高压成型、高温烧成，其矿物组成主要为莫来石晶相。

该产品具有高温结构强度高、高温蠕变低，抗热震性能优良的特点。

该产品应用于大型高炉的热风炉主、支管及蓄热室墙。

主要技术参数



产品名称	致密粘土砖	低蠕变莫来石砖						
牌号	XN-52	XRL-155	XRL-150	XRL-145	XRL-140	XRL-135	XRL-130	XRL-127
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	≥42	≥75	≥80	≥65	≥65	≥65	≥60	≥50
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤2	≤2	≤2	≤2
显气孔率 %	≤15	≤20	≤21	≤19	≤23	≤23	≤23	≤23
体积密度 g/cm <sup>3</sup>		≥2.6	≥2.7	≥2.45	≥2.4	≥2.4	≥2.35	≥2.35
常温耐压强度 Mpa	≥50	≥60	≥55	≥60	≥50	≥45	≥45	≥45
耐火度 ℃	≥1730	≥1850	≥1850	≥1850	≥1820	≥1790	≥1790	≥1790
0.2Mpa 荷重软化温度	T2 ≥1500							
蠕变率 x50h 0.2Mpa % ( ) ℃		≤0.8 (1550)	≤0.8 (1500)	≤0.8 (1450)	≤0.8 (1400)	≤0.8 (1350)	≤0.8 (1300)	≤0.8 (1270)

锆质系列制品

锆刚玉砖高温结构强度高，耐碱性介质侵蚀性能好，应用于大型浮法玻璃窑熔化池、显象管窑炉、蓄势室墙砖等。

高密度锆英石砖具有较好的机械强度、良好的抗热震性和耐玻璃液侵蚀，应用于钠-钙玻璃中层砖层、拱脚砖等。



主要技术参数

产品名称	二次烧结锆刚玉砖				高密度锆英石砖
牌号	XAZS-32A	XAZS-32B	XAZS-24	XAZS-20	XZS-65
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	≥55	≥46	≥50	≥58	
ZrO <sub>2</sub> %	≥32	≥32	≥24	≥18	≥65
SiO <sub>2</sub> %	≤17	≤18	≤22	≤22	≤34
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %				≤0.25	≤0.5
TiO <sub>2</sub> %				≤0.6	
显气孔率 %	≤18	≤18	≤18	≤18	≤17
体积密度 g/cm <sup>3</sup>				≥2.8	≥3.75
常温耐压强度 Mpa	≥80	≥80		≥80	≥80
耐火度 SK					≥40
0.2Mpa 荷重软化温度	≥1680	≥1650	≥1630	T2 1650	≥1650
热膨胀率 1000℃ %					≤0.45
重烧线变化 1600℃X3h 1500℃X2h	≤0.3	≤0.3			
气泡析出率	≤3	≤5			
热震稳定性 1100℃ 风冷 次				≥25	

## 铝硅系列制品

堇青石-莫来石砖热膨胀系数小、抗热震性优良、应用于热风炉燃烧器组合砖。

烧结莫来石砖的主要矿物组成为莫来石晶相。该产品具有较高的高温结构强度、耐化学侵蚀好，应用于高温窑炉内衬。

硅线石砖具有较高的高温结构强度、高温蠕变低，热震稳定性良好。应用于高炉、热风炉风管、石灰窑、玻璃熔炉的料道及盖板。



主要技术参数

产品名称	莫来石砖		刚玉-莫来石砖		堇青石-莫来石砖	硅线石砖
牌号	XM-68	XM-72	XCM-75	XCM-80	XJM	XGC
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	≥68	72	≥75	≥80	≥50	≥55
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	≤1.5	≤1.5			≤2	≤1.5
MgO %					1.7-3	
SiO <sub>2</sub> %					≤45	
显气孔率 %	≤21	≤19	≤17	≤17	≤27	≤17
体积密度 g/cm <sup>3</sup>	2.45	2.50	2.55	2.6	≥2.05	≥2.45
常温耐压强度 Mpa	≥50	≥60	≥70	≥70	≥30	≥55
常温抗折强度 Mpa			≥15	≥15		
0.2Mpa 荷重软化温度	≥1580	≥1600	≥1680	≥1700		≥1550(T2)
热膨胀系数 20-1000℃ °C	4.5-4.9				≥60	≥15
热稳定性 1100℃ 水冷 次						

轻质砖系列制品

轻质高铝砖及粘土砖具有良好的隔热性能，应用于窑炉隔热层。



主要技术参数

产品名称	轻质高铝砖			轻质粘土砖		
牌号	XQL-0.8	XQL-1.0	XQL-1.2	XQN-0.8	XQN-1.0	XQN-1.2
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	≥48	≥48	≥48			
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	≤2.0	≤2.0	≤2.0			
显气孔率 %						
体积密度 g/cm <sup>3</sup>	≤0.8	≤1.0	≤1.2	≤0.8	≤1.0	≤1.2
常温耐压强度 Mpa	≥3	≥4	≥4.5	≥2.5	≥3.0	≥4
0.2Mpa 荷重软化温度	≥1400	≥1400	≥1450	≥1250	≥1350	≥1400
导热系数 1000℃	≤0.35	≤0.50	≤0.55	≤0.35	≤0.50	≤0.60